

研究成果報告書 (掲載期間 2020.11.1-2021.10.31)

学術書

- (1) 羽深等, 宮代文夫, 山田靖: 先端パワーデバイス実装技術, 第4章第2節 pp.148-168, シーエムシー出版, 2021.

学会発表

- (1) 山田靖, 八坂慎一, 大浦賢一, 東条三秋: パワー半導体実装用接合材料の基礎物性と信頼性評価法, エレクトロニクス実装学会, MES2021, 2021年9月, オンライン開催.

その他

- (1) 山田靖: 次世代パワーデバイス実装技術講座 パワーデバイス実装用接合技術, エレクトロニクス実装学会誌, Vol.24, No.6, pp.614-618, 2021年9月.
- (2) 山田靖: Cu ナノ粒子を用いた高耐熱接合技術と特性評価, MATERIAL STAGE, Vol.21, No.1, pp.75-85, 2021年4月.
- (3) 山田靖: 特集/エレクトロニクス実装技術の教育 特集に寄せて, エレクトロニクス実装学会誌, Vol.24, No.6, p.483, 2021年9月.